

科技工程與管理學系 107學年度入學學生適用(110.12.28修訂)

自選各模組應修學分數 至少12學分	大一		大二		大三		大四		不分學年、期課程	學分數	
	上學期	學分數	下學期	學分數	上學期	學分數	下學期	學分數			上學期
校必修 (28學分)	英文 I 2 體育 I 0 體驗學習 1 音樂欣賞 2 資訊倫理 2	英文 II 2 體育 II 0 國文 2 長榮精神 2	外語初級 I 2 體育 III 0 服務學習 1	外語初級 II 2 體育 IV 0					經典99 2 通識課程 8		
本系必修 (29學分)		經濟學 2	工程數學I 3	電子學 3	控制系統 3	專題實作I 1	專題實作II 1				
院共同 必修 (19學分)	資訊暨設計體驗課程 2 計算機概論 3 基礎程式設計 3 設計美學 2 電腦繪圖技法 3	物理學 3 邏輯設計 3 邏輯設計實習 1 微積分 3 程式設計 3	電路學 3 管理學 3	線性代數 3							
A機器人綜合模組 最低應修12學分			創意機器人 3 3D成型與設計 3 感測器理論與應用 3	飛行控制程式設計 3	機電整合 3	機器視覺 3 深度學習實務 3	智慧機器人應用專案 3				
B智慧物聯網應用實務 模組 最低應修12學分			物聯網概論 3 互動程式設計I 3	嵌入式系統 3 互動程式設計II 3	物聯網大數據分析 3	人工智慧實務 3 智慧物聯網專題製作 3	智慧健康照護 3				
C商業大數據實務模組 最低應修12學分			企業資源規劃 3 資料庫應用 3	商業智慧概論 3 資料庫應用 3	社群與網路應用 3 統計應用 3	資料探勘 3 資料視覺化應用 3	大數據資料分析 3				
院共同選修	辦公室軟體應用 2 無人機空拍 2	工程概論 2	綠色能源概論 3 數位系統設計 3 計算機組織 3 計算機網路 3 資料結構 3	視窗程式設計 3 物件導向程式設計 3 工程數學II 3 人力資源管理 3 超大型積體電路設計導論 3 單晶片應用設計 3 作業系統實務 3 電路學實習 1 電磁學 3	視窗程式設計 3 物件導向程式設計 3 工程數學II 3 人力資源管理 3 超大型積體電路設計導論 3 單晶片應用設計 3 作業系統實務 3 電路學實習 1 電磁學 3	電子學實習 1 專題計畫導論 1 創意設計 3 數值方法與電腦應用 3 通訊電子學 3 數位積體電路 3 工程應用程式設計 3 訊號與系統 3 專案管理 3	專題討論I 2 離散數學 3 行動裝置程式設計 3 通訊系統 3 圖控介面與程式設計 3	專題討論II 2 科技管理 3 積體電路應用設計 3 數位訊號處理 3 數位影像處理 3 企業實習I 3 企業實習II 3 企業實習III 3	企業實習IV 3 企業實習V 3 企業實習VI 3	資訊暨設計學院微 學分 I 1 資訊暨設計學院微 學分 II 1 跨領域微學分 I 1 跨領域微學分 II 1 跨領域微學分 III 1	
本系選修	會計學 2 專業英文 2 企業概論 2										

科技工程與管理學系課程地圖

對應職業	<b>機器人綜合模組</b> 機器人開發/應用/維修/銷售工程師	<b>智慧物聯網應用實務模組</b> 物聯網應用工程師/開發工程師/軟體工程師	<b>商業大數據實務模組</b> 商業智慧分析師/資料分析工程師/模型建置與分析師/大數據工程師
------	-------------------------------------	--	---